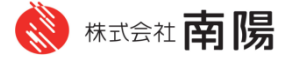


2025年5月14日

各位



【出展のお知らせ】2025NEW 環境展

当社は「2025NEW 環境展」に共同開発会社である株式会社アステック入江及び当社子会社である株式会社浜村と共同出展いたします。

この機会に是非、当社ブースにお立ち寄りください。



会 期 : 2025年5月28日(水)~5月30日(金)

開 場 時 間 : 10:00~17:00 (最終日は16:00まで)

会 場 : 東京ビッグサイト 東1ホール

当社ブース : A118

問い合わせ先: (株)南陽 産機事業本部 北九州支店 [TEL:093-645-0120](tel:093-645-0120)

(株)浜村 [TEL:093-293-6781](tel:093-293-6781)

【展示内容】

1. 電子部品剥離装置「HS-II」
2. 電子部品選別装置「AIS」
3. レアメタル湿式回収システム「アステックシステム」

PC・携帯電話・家電等の廃基板の電子部品には、いわゆる「都市鉱山」の代表的な存在である金、パラジウム、タンタル等の希少金属が含まれ、近年非常に関心が高まっております。その都市鉱山リサイクルシステムの新機軸として、効率よく安定的にレアメタルを回収できるシステムを開発いたしました。

当社は、このシステムの普及により経済的合理性を高め、再生資源の利用とサーキュラーエコノミーへの転換を促進し、持続可能な社会実現に貢献してまいります。

## 【主な製品のご紹介】

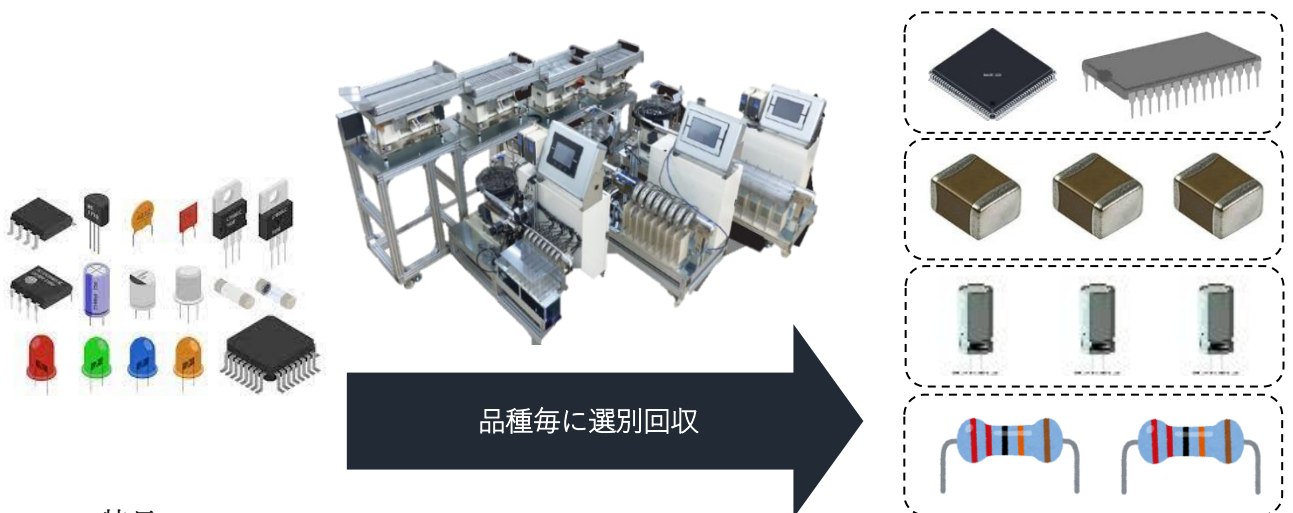
### 1. 電子部品剥離装置「HS-II」



#### <特長>

- ・廃基板から電子部品を剥離 → 基板は銅の回収工程へ、電子部品はAI選別工程へ
- ・電子部品原型のまま回収 → AI選別工程にて各電子部品の種別回収を可能に！
- ・省人設計 → 基板投入～部品回収作業をワンオペレーション化

### 2. 電子部品選別装置「AIS」

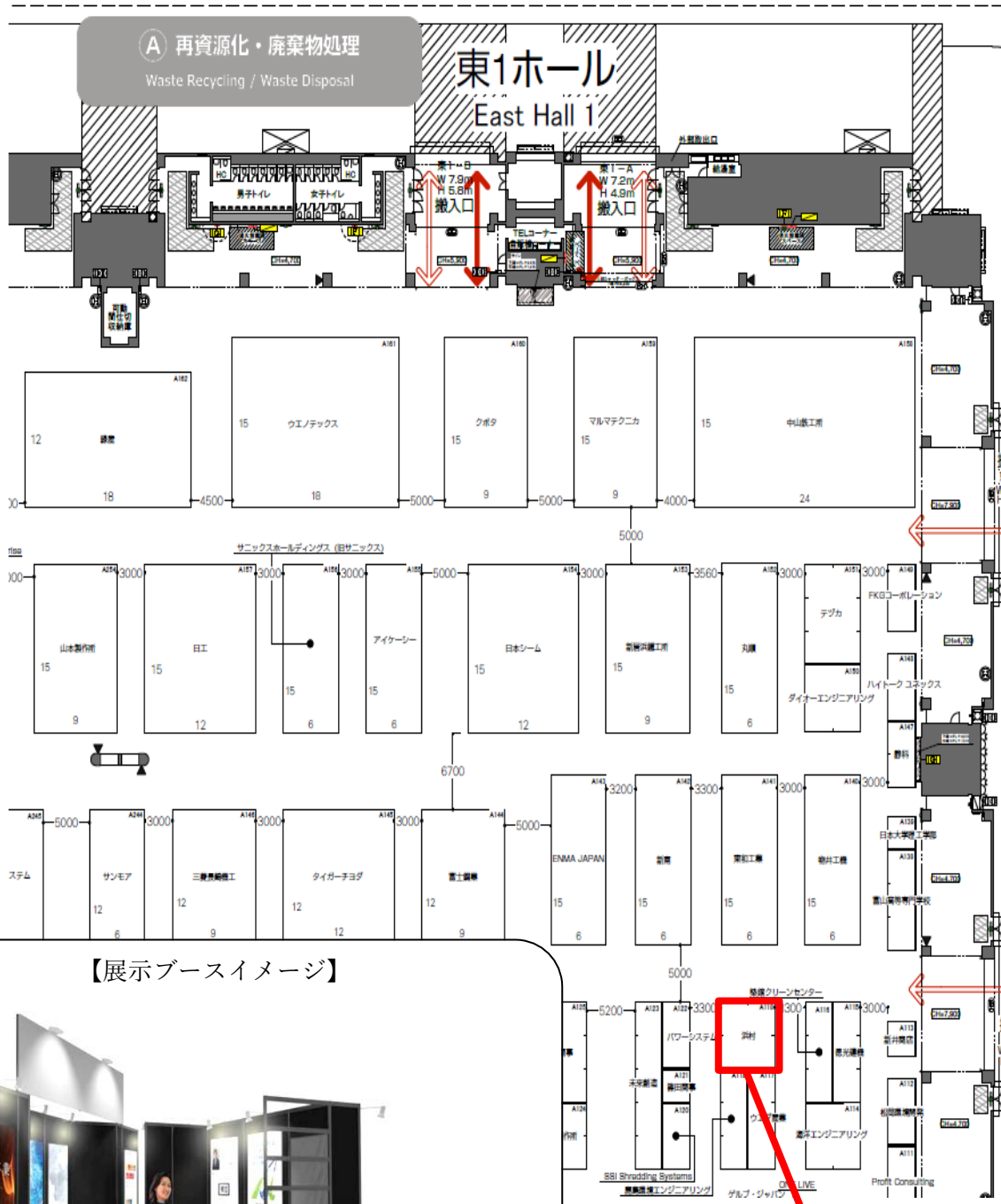


#### <特長>

- ・前工程（HS-II）で基板から剥離した各種電子部品を、種別毎に選別
- ・AIによる高精度/高速画像選別が可能。部品群に合わせて最適化したAIで選別
- ・処理速度：最速 0.1s/pcs
- ・フルオートによる省人化を実現

HS-II、AISにより、狙いの希少金属を濃縮化させ、効率よい資源回収を実現いたします。  
電子部品選別装置「AIS」は会場にて、実演デモを予定しております。

【入場事前登録 URL】 <https://nexpo.ex-system.tech/visitor/>



【展示ブースイメージ】



当社ブース：東1ホール A118

以上